行政院國家科學委員會專題研究計畫 期中進度報告

微結構之顯微電性量測(2/3)

計畫類別: 個別型計畫

計畫編號: NSC93-2112-M-009-012-

<u>執行期間</u>: 93 年 08 月 01 日至 94 年 07 月 31 日 <u>執行單位</u>: 國立交通大學電子物理學系(所)

計畫主持人: 陳衛國

共同主持人: 陳文雄, 李明知

報告類型: 精簡報告

處理方式:本計畫可公開查詢

中華民國94年6月1日

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

微結構之顯微電性量測(2/3)

計劃編號: NSC-93-2112-M-009-012

執行期間: 93/8/1~94/7/31

主持人:陳衛國 交通大學電子物理系

一、中文摘要

在本期計畫中我們利用導電性原 子力顯微系統(C-AFM)及微拉曼系統 進行氮化鎵表面 V 型微結構的顯微電 性及結構量測。我們發現無論是在平 坦表面或是 V型微結構區域, Fowler-Nordheim 場激發穿隧機制都可 以解釋局域電流的行為。對於一個大 小為 2μm 左右的 V 型微結構 , 局域電 流-電壓特性顯示在側壁、邊緣及稜線 部分的起始電壓分別為 0.80、0.65 及 0.50V, 遠比在平坦表面處 3.25V 為 低。微拉曼光譜量測發現 V 型微結構 區域內氮化鎵 A₁(LO)模由 735cm⁻¹ 藍 移至 740cm-1, 代表聲子與密度為 8x 10¹³cm⁻²的表面電子耦合。在 V 型微結 構累積的電子代表較高的表面能態密 度,導致較低的穿隧能障高度。我們 認為這是導致 V 型微結構具有較低起 始電壓的主要原因。

二、英文摘要

GaN hexagonally-shaped inversed pyramid, hence V-defect, was studied comprehensively by using conductive atomic force microscopy (C-AFM) and micro-Raman spectroscopy. C-AFM results indicate that the localized current-voltage characteristics basically follow the Fowler-Nordheim carrier transport

mechanism. regardless measurement at area inside and outside of the V-defect. The corresponding turn-on voltages at flat region, and off-axis facet, hexagonal perimeter and crest line of V-defect are 3.25, 0.80, 0.65, and 0.50V, respectively. It is clearly that the turn-on voltages at V-defect region are considerably lower than that at flat Micro-Raman measurement further reveals that there exist sheet carrier concentration as high as 8x10¹³ cm⁻² accumulated on the surface inside the V-defect region, as evidenced from the observation of a blue-shift from 735 to 740cm⁻¹ of A₁(LO) signal. Such a high accumulation of surface carrier concentration will certainly lower down the barrier height of GaN at V-defect, which we believed is the primary reason responses for the low turn-on voltage of I-V characteristics observed at V-defect region in our study.

三、緣由與目的

在上一期計畫中我們發現到對於 氮化鎵(GaN)薄膜的V型微結構區域的 側壁部分,和平坦表面相比具有較低的 起始電壓,以及較高的表面能態密度。 為了更精確的描述這些特性,在這個計 畫年度,我們利用Fowler-Nordheim場 激發機制來描述電流傳導機制。除此之 外, 微拉曼光譜則是顯示V型微結構的 晶格特性, 藉此了解表面能態的來源。

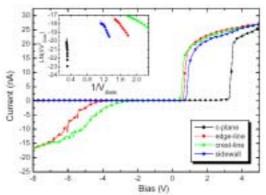
四、實驗步驟

本實驗採用低壓有機金屬化學氣相沉積系統(MOVPE)將氮化鎵薄膜成長在(0001)面之藍寶石(Al₂O₃)基板上。經由成長不同厚度的氮化鎵鋁(AlGaN)低溫成核層,以調變與藍寶石基板間晶格不匹配產生之應力;之後將反應腔溫度升高至 1120 成長厚度約2 微米的氮化鎵薄膜。我們可以藉此控制不同的V型微結構的密度以及大小。

我們利用 NT-MDT 公司生產的 Solver HV 原子力顯微鏡系統,在真空度約10⁻⁶ torr 的環境下進行變溫顯微電性分析,藉此釐清局域電流的傳導機制。至於微拉曼光譜則是利用本實驗室自組的拉曼系統和聚焦透鏡,在波長488nm 的氫離子雷射激發下進行。

五、結果與討論

圖一為氮化鎵表面一個尺寸 2μmV 型微結構的局域電流 - 電壓 (current-voltage)特性譜圖,可以很清楚 地發現到在 V 型微結構內,側壁部分 的順向起始電壓約在 0.80V, 而邊緣和 稜線更降低至 0.65 及 0.50V, 遠比在 平坦表面處 3.25V 為低。而在反向偏 壓情形下,在 V 型微結構的稜線及邊 緣處,當反向偏壓大於-2 及-4V 時反向 漏電流比其他區域來大兩個數量級以 上。上個計劃年度我們認為這可能是 由於 V 型微結構區域內的表面能態密 度較平坦處高所致,在這個計劃年 度,我們將更深入的定量討論電流經 由 V 型微結構的傳導機制以及表面能 熊密度的來源。



圖一 V 型微結構的室溫局域電流-電壓特性

從圖一的插圖我們發現無論在 V型微結構區域或是平坦處,ln(I/V²)對 1/V 的特性圖都呈現線性關係,代表經由 AFM 探針傳輸的電流,無論是否有微結構存在,都遵守 Fowler-Nordheim穿隧電流機制,在以下的討論當中我們將定量地計算不同區域的斜率變化。

由於氮化鎵表面很容易形成一層厚度約2 奈米左右的自發氧化層(native oxide),金屬探針在接觸式模式(contact mode)時和氮化鎵的接面可以視作一個金屬-氧化層-半導體(MOS)接面。當外加偏壓落在氧化層時,能帶形狀因電場作用而降低等效氧化層厚度,造成 Fowler-Nordheim 穿隧電流[1]。如公式(1)所示:

$$I \propto A \frac{V^2}{\Phi^2 d^2} \exp[-\frac{d}{V}\Phi^{2/3}]$$
, (1)

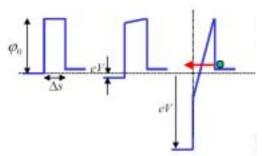
其中 Φ 代表能障高度而 d 代表氧化層厚度。

我們將 $ln(I/V^2)$ 對 1/V 關係的斜率代入公式(1),假設自發氧化層的厚度為 3 奈米,我們可以計算出不同位置的能障高度:

	平坦	側壁	邊緣	稜線
能障高	3.2	0.6	0.5	0.3

在平坦表面區域的能障高度為 3.2 電子伏特,符合氮化物氧化層(Al₂O₃)和氮化鎵的電子親和力差值[2],如圖

二的能帶圖所示。當開始外加順向偏壓時能障高度降低,進而增加穿隧電流;但當外加偏壓大於能障高度時,整個方形能障被扭曲成三角形,氧化層等效厚度降低,穿隧機率因而大幅度上升,此時電流傳導機制遵守公式(1)所示,由 Fowler-Nordheim 激發所主導。

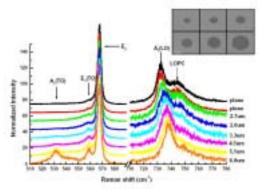


圖二 Fowler-Nordheim 激發電流示意圖

至於在 V 型微結構區域,由圖一 我們發現當起始電壓(turn-on voltage) 降低至 1V 以下, ln(I/V2)對 1/V 的斜率 也隨之降低接近兩個數量級 由公式(1) 可以發現在 V 型微結構內電流傳導仍 然遵守 Fowler-Nordheim 機制,能障高 度則是降低至 0.3-0.6 電子伏特。由以 上的實驗結果顯示,我們利用局域電 流-電壓特性可以定量地量測出微結構 內的能障高度,和上個計畫年度相比 較,在 V 型微結構區域內,有可能是 因為表面能態密度增加,導致穿隧能 障高度降低。為了解釋為何在 V 型微 結構區域較高的表面能態密度,我們 另外進行不同大小的 V 型微結構的微 拉曼光譜量測(micro-Raman spectra), 以計算表面能態密度。

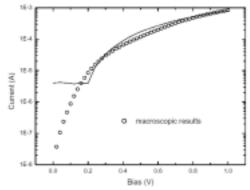
微拉曼光譜如圖三所示,當 V 型 微結構的大小由 $2.7\mu m$ 增加至 $6.0\mu m$ 時並不會產生 E_2 模的波數位移,代表沒有應力累積或是釋放。相反的我們卻觀察到 $A_1(LO)$ 模在微結構域內有藍位移的現象,這是由於表面光學聲子以及聲子(phonon)和電子的耦合效應,在平坦表面拉曼位移波數大約在 $734cm^{-1}$,而在 V 型微結構區域內隨著

尺寸大小增加,逐漸增加至 $740 \, \mathrm{cm}^{-1}$,。 利用聲子與電子耦合的關係,我們計算出在 V 型微結構內的電子密度在 $6.0 \, \mu \mathrm{m}$ 的 V 型微結構達到 $8 \times 10^{13} \, \mathrm{cm}^{-2}$ 。 我們相信這是因為 V 型微結構內的表面能態密度較平坦處高,因此容易引起電子聚集 [3],以致於能障高度降低,較容易在低偏壓時形成穿隧電流。



圖三 不同尺寸 V 型微結構的維拉曼光譜分析

在上個年度我們已經發現當大面 積蕭基元件結構具有密度 10⁷ cm⁻²的 V 型微結構時,電流遠比密度低於 105 cm⁻² 的元件為大。相較於顯微電流電 壓結果,這是因為在 V 型微結構區域 內起始電壓遠較平坦表面低,因此在 低順向偏壓(<1V)時,流經過V型微結 構的電子將較平坦處大至少三個數量 級以上。當我們考慮 V 型微結構密度 以及大小計算 V 型微結構的總面積, 可以得到當增加 V 型微結構的密度到 其總面積無法忽略的程度時,將能夠 主導整個元件的巨觀電流。圖五呈現 當 V 型微結構大小約 300-400nm, 密 度大約在 1.5×10⁷cm⁻² 時, 對於一個接 觸半徑為 50 um 的蕭基元件而言,順向 電流幾乎都由 V 型微結構所提供綜合 磊晶過程中對於 V 型微結構的控制以 及顯微電性量測的結果,對於日後元 件結構如何降低發光元件起始電壓以 及抑制反向漏電流,將會有極大的助 益。



圖四 V型微結構密度 10⁷cm⁻² 時對巨觀電流的貢獻

六、結論

在本期計畫中我們延續上期的結 果,進行氮化鎵表面 V 型微結構的顯 微電性及結構量測。對於一個大小為 2μm 左右的 V 型微結構, 局域電流-電 壓特性顯示在側壁部分的順向起始電 壓約在 1.0V , 而邊緣和稜線更降低至 0.6 及 0.8V, 遠比在平坦表面處 3.0V 為低。利用 Fowler-Nordheim 場激發穿 隧機制擬合,我們發現在微結構區域的 穿隧能障較平坦處為低,有可能是因為 表面能態密度增加所致 利用微拉曼光 譜量測發現到的 A₁(LO)及 LOPC 模藍 移,我們證明在 V 型微結構區域的確 具有較高的表面能態密度。此外,由於 V 型微結構具有較低的起始電壓,在較 低順向偏壓時具有較平坦處高約 1000 倍以上的電流,因此當密度大於 1.5x 10⁷ cm⁻² 時其總電流值遠大於平坦表 面,並完全主導巨觀元件的順向電流, 這個結果對於日後元件結構的製備,例 如發光元件起始電壓的控制有極大的 幫助。

七、參考資料

- [1] M. Lenzlinger, and E. H. Snow, J. Appl. Phys. 40:278 1969
- [2] H. Asahi, et al., Thin Solid Film, **464**:128 2004
- [3] N. G. Weimann, et al., J. Appl. Phys. **83**:3656 1998